



中华人民共和国有色金属行业标准

YS/T 614—2006

银钯厚膜导体浆料

Sliver palladium thick film conductor paste

2006-05-25 发布

2006-12-01 实施

中华人民共和国国家发展和改革委员会 发布

中华人民共和国有色金属
行业标准
银钯厚膜导体浆料
YS/T 614—2006

*

中国标准出版社出版发行
北京西城区复兴门外三里河北街16号
邮政编码:100045

<http://www.spc.net.cn>

<http://www.gb168.cn>

电话:(010)51299090、68522006

2006年9月第一版

*

书号:155066·2-17106

版权专有 侵权必究
举报电话:(010)68522006

前 言

本标准的附录 A 为资料性附录。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会提出并归口。

本标准由贵研铂业股份有限公司负责起草。

本标准主要起草人：张晓民、范顺科、杨雯、陈伏生、刘林、陈一、金勿毁、贺东江、严先雄。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会负责解释。

银钯厚膜导体浆料

1 范围

本标准规定了银钯厚膜导体浆料的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存及订货单内容等。

本标准适用于厚膜混合电路、分立器件用银钯导体浆料(以下简称银钯浆料)。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。

GB/T 17473.1	厚膜微电子技术用贵金属浆料测试方法	固体含量测定
GB/T 17473.2	厚膜微电子技术用贵金属浆料测试方法	细度测定
GB/T 17473.3	厚膜微电子技术用贵金属浆料测试方法	方阻测定
GB/T 17473.4	厚膜微电子技术用贵金属浆料测试方法	附着力测定
GB/T 17473.5	厚膜微电子技术用贵金属浆料测试方法	粘度测定
GB/T 17473.7	厚膜微电子技术用贵金属浆料测试方法	可焊性、耐焊性试验

3 定义

下列定义适用于本标准。

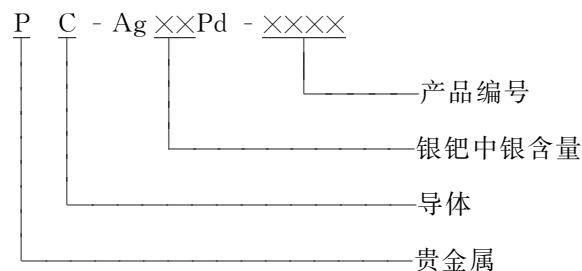
银钯厚膜导体浆料 silver palladium thick film conductor paste

由银粉、钯粉、无机添加剂和有机载体组成的一种满足于印刷或涂敷特性的膏状物。

4 要求

4.1 产品标记

银钯浆料的牌号标记方法如下:



示例:PC-Ag90Pd-2010,表示为AgPd浆料20系列,银钯比为:90/10。

4.2 银钯浆料的组成

银钯浆料由银粉、钯粉、无机添加物和有机载体组成。

4.3 银钯浆料的烧成条件:银钯浆料印刷在氧化铝(96%)基板上,烧成峰值温度 $850^{\circ}\text{C} \pm 10^{\circ}\text{C}$,峰值保温 10 min,烧结周期 30 min~60 min。

4.4 性能

4.4.1 银钯浆料的固体含量、细度、粘度应符合表1的规定。